



FATC 記憶體最佳代工夥伴

福懋科技 2023年法人說明會

總經理暨發言人 張憲正

2023年11月16日

免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。

會議議程

- 1 2023年第3季營運績效及財務狀況
- 2 研究發展與規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答

1

2023年第3季 營運績效及財務狀況



2023年第3季財務摘要

單位:新台幣仟元

項目	2023年第3季		2023第2季		較上季差異		2022年第3季		較去年同期差異	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,641,108	100.0	1,880,837	100.0	-239,729	-12.7	2,670,776	100.0	-1,029,668	-38.6
營業毛利	788	0.0	132,211	7.0	-131,423	-99.4	559,455	20.9	-558,667	-99.9
營業利益(損)	-73,080	-4.5	69,740	3.7	-142,820	-204.8	497,628	18.6	-570,708	-114.7
稅前息前折舊攤銷前利益	342,115	20.8	545,506	29.0	-203,391	-37.3	1,092,354	40.9	-750,239	-68.7
營業外收入(支出)	127,798	7.8	179,404	9.5	-51,606	-28.8	275,467	10.3	-147,669	-53.6
所得稅利益(費用)	-10,953	-0.7	-18,236	-1.0	7,283	-	-146,278	-5.5	135,325	-
本期淨利	43,765	2.7	230,908	12.3	-187,143	-81.0	626,817	23.5	-583,052	-93.0
每股盈餘(元/股)	0.10		0.52		-0.42		1.42		-1.32	
每股淨值(元/股)	26.44		26.71		-0.27		28.06		-1.62	

2023年第3季綜合損益表

單位:新台幣仟元

項 目	2023年第3季		2023年第2季		較上季差異		2022年第3季		較去年同期差異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
會計科目										
營業收入	1,641,108	100.0	1,880,837	100.0	-239,729	-12.7	2,670,776	100.0	-1,029,668	-38.6
營業成本	1,640,320	100.0	1,748,626	93.0	-108,306	-6.2	2,111,321	79.1	-471,001	-22.3
營業毛利	788	0.0	132,211	7.0	-131,423	-99.4	559,455	20.9	-558,667	-99.9
銷管費用	31,353	1.9	21,876	1.2	9,477	43.3	22,259	0.8	9,094	40.9
研發費用	42,515	2.6	40,595	2.2	1,920	4.7	39,568	1.5	2,947	7.4
營業利益(損)	-73,080	-4.5	69,740	3.7	-142,820	-204.8	497,628	18.6	-570,708	-114.7
業外收入(支出)	127,798	7.8	179,404	9.54	-51,606	-28.8	275,467	10.3	-147,669	-53.6
稅前淨利	54,718	3.3	249,144	13.2	-194,426	-78.0	773,095	28.9	-718,377	-92.9
所得稅利益(費用)	-10,953	-0.7	-18,236	-1.0	7,283	-	-146,278	-5.5	135,325	-
本期淨利	43,765	2.7	230,908	12.3	-187,143	-81.0	626,817	23.5	-583,052	-93.0
每股盈餘(元/股)	0.10		0.52		-0.42		1.42		-1.32	
每股淨值(元/股)	26.44		26.71		-0.27		28.06		-1.62	

2023年第3季與2023年第2季差異說明

單位:新台幣仟元

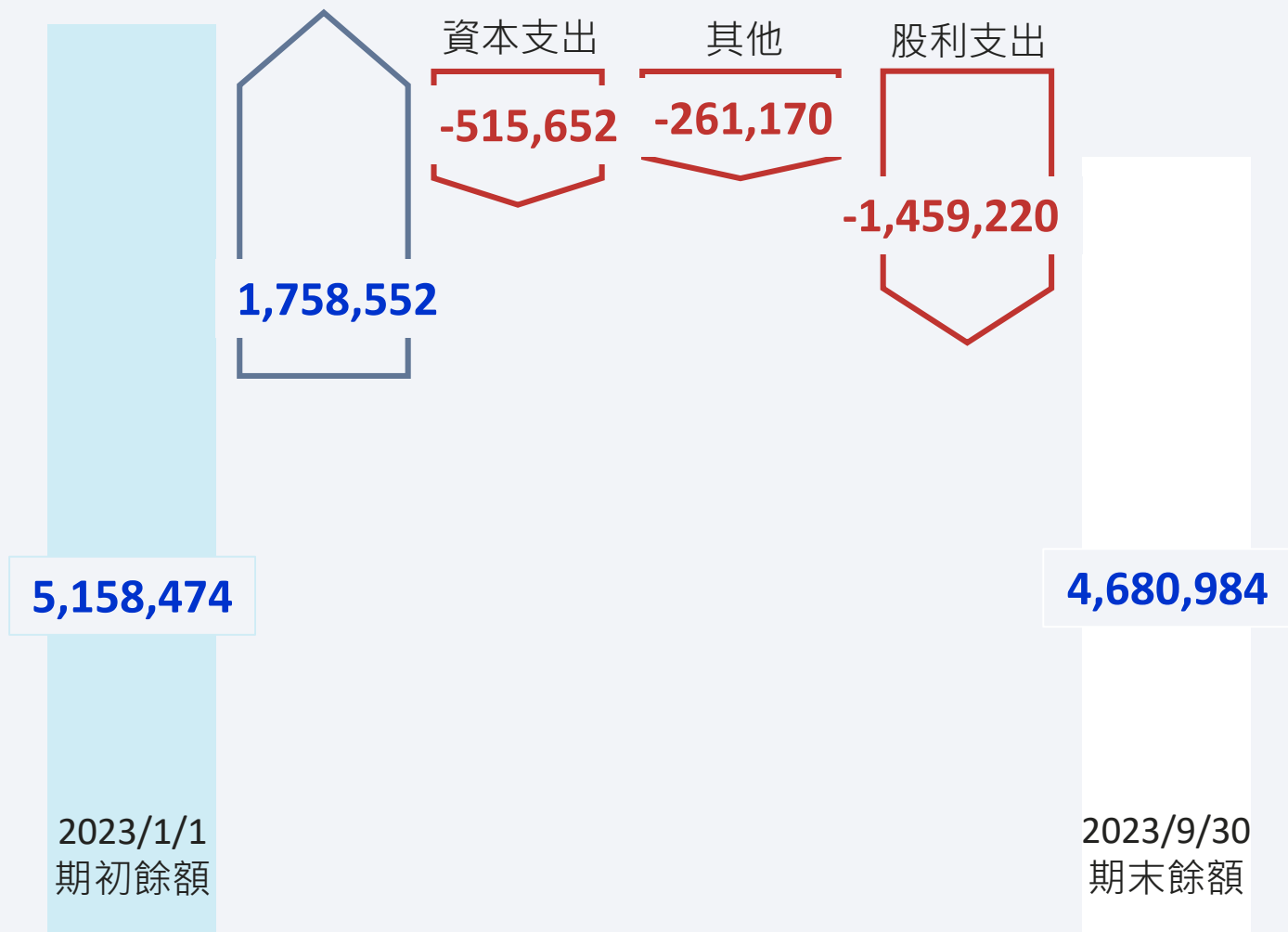
項目 會計科目	2023年Q3		2023年Q2		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入	1,641,108	100.0	1,880,837	100.0	-239,729	-12.7	銷售量季減低十位數百分比，平均代工單價季減低個位數百分比，匯率影響有利低個位數百分比。
營業毛利	788	0.0	132,211	7.0	-131,423	-99.4	2023年Q3毛利季減99.4%，主要係銷售量減少、代工單價降低。
營業費用	73,868	4.5	62,471	3.3	11,397	18.2	2023年Q3營業費用季增11,397仟元，主要為推銷管理費用增加9,477仟元及研發費用增加1,920仟元。
營業利益(損)	-73,080	-4.5	69,740	3.7	-142,820	-204.8	2023年Q3營業利益季減142,820仟元，主要為毛利減少131,423仟元、營業費用增加11,397仟元。
本期淨利	43,765	2.7	230,908	12.3	-187,143	-81.0	本期淨利季減187,143仟元，主要為營業利益減少142,820仟元、利息收入減少4,081仟元、兌換盈餘增加31,109仟元、其他收入減少74,650仟元及所得稅費用減少7,283仟元。

現金流量表

單位:新台幣仟元

	2023年 Q3	2023年 Q2
期初餘額	5,710,753	5,423,832
營業活動之現金流量	536,101	518,674
資本支出	-95,330	-238,662
其他	-11,320	6,909
股利支出	-1,459,220	0
期末餘額	4,680,984	5,710,753
自由現金流量	440,771	280,012

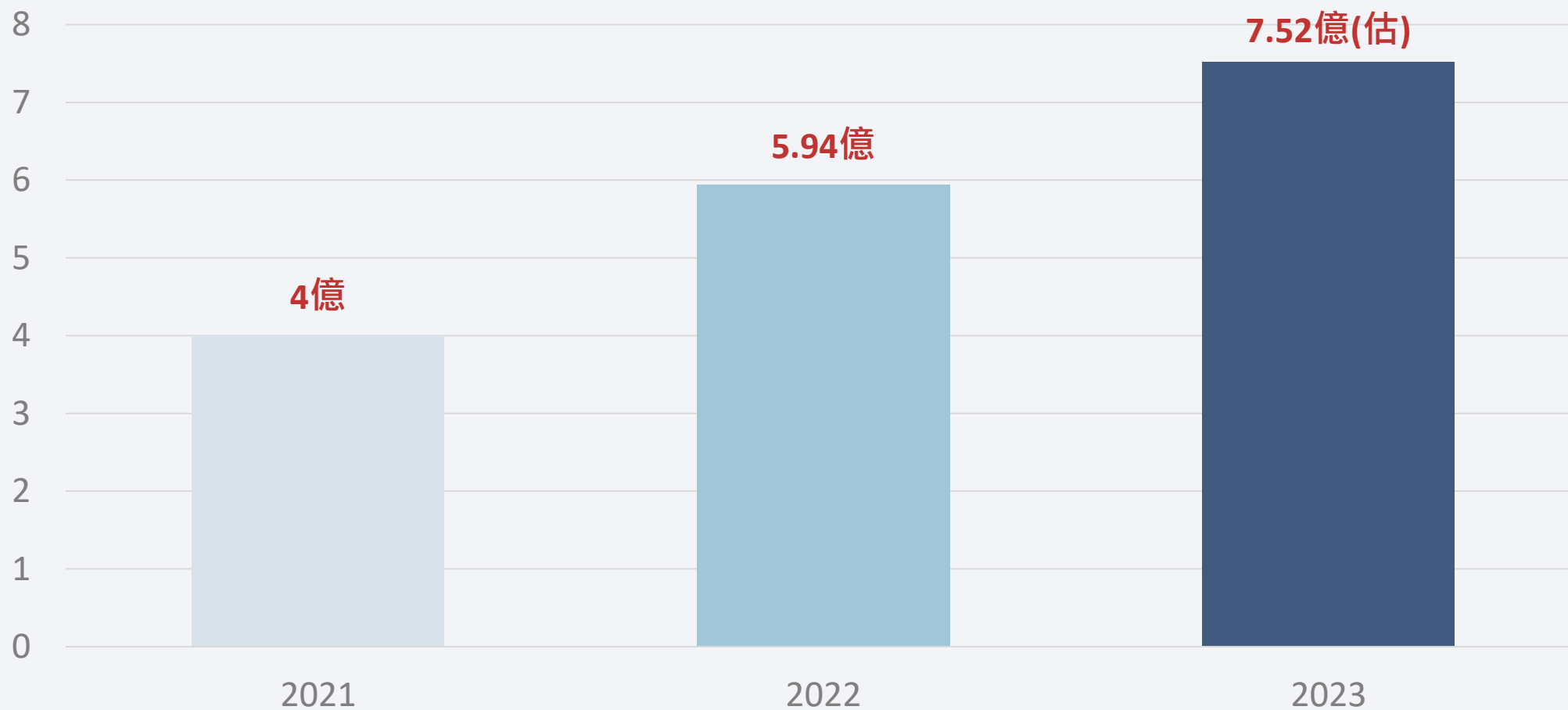
營業活動之現金流量



2023年第1~3季自由現金流量為 1,242,900 仟元

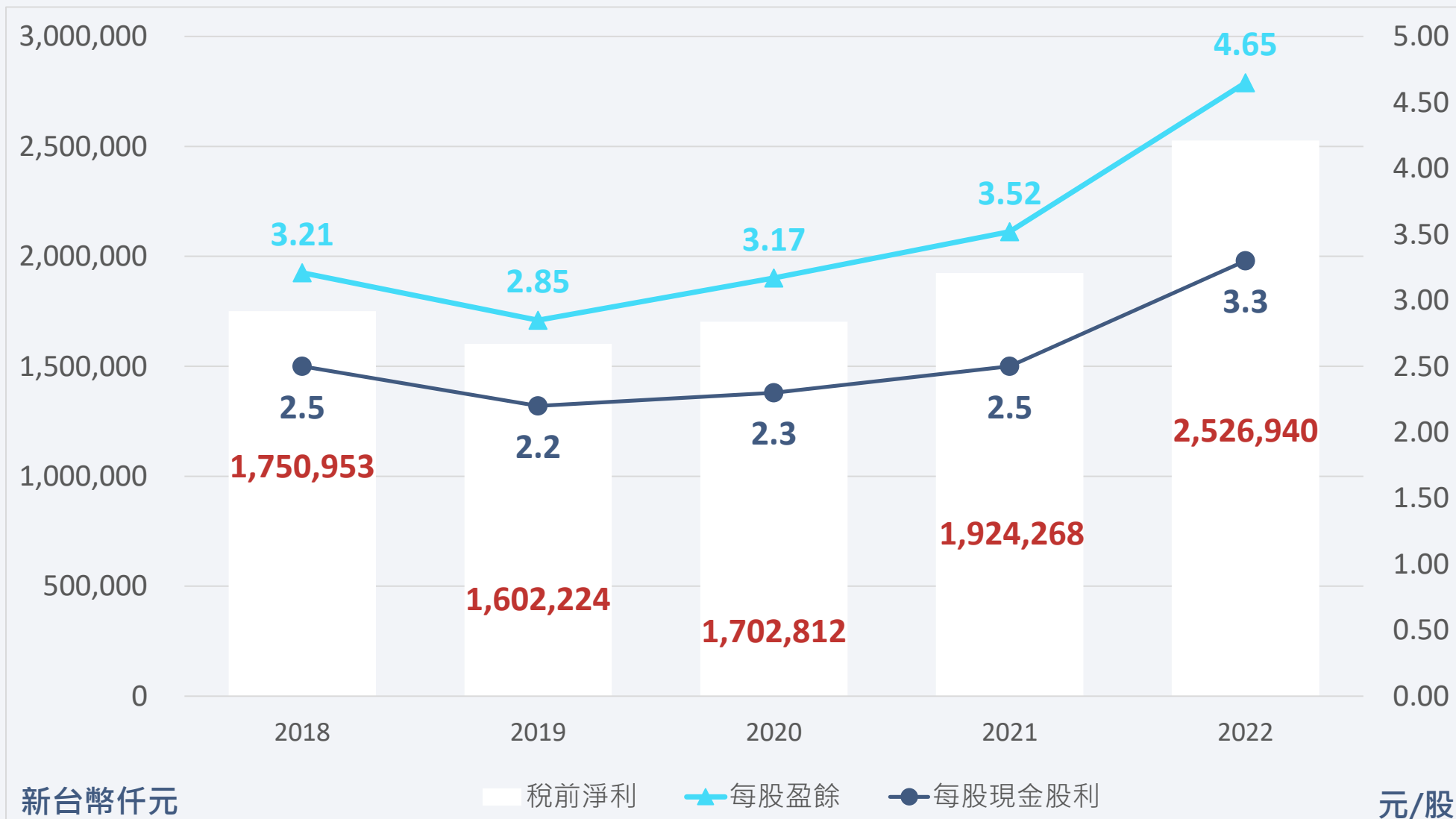
歷年資本支出

單位:新台幣億元

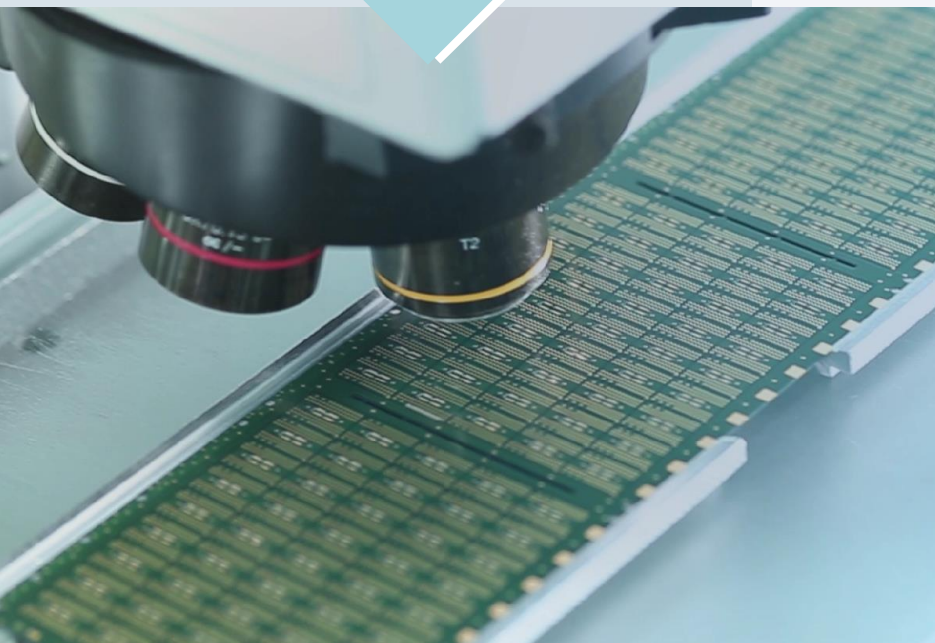


近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣仟元



2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

日前終端產品需求回升，產業記憶體產品高速及高容量持續發展，福懋科未來研發方向：

1

因應產業技術發展，終端產品需求開始回升，已陸續量產覆晶封裝記憶體產品，並著手開發覆晶凸塊(Bumping)及晶圓重新佈線(RDL)等製程技術。

2

未來記憶體朝高速度及高容量趨勢發展，2023年已完成DDR5 8Gb 10奈米級第一代製程封裝測試開發，目前積極進行DDR5 16Gb 10奈米級第二代製程封裝測試開發，以符合客戶2024年的產品發展趨勢。

3

目前正積極進行3D TSV製程技術研發，包含晶圓背面凸塊裸露(Reveal)及覆晶上片堆疊、封裝技術，為未來記憶體高速度及高容量需求提前佈局。

3

營運重點與 市場展望



營運重點

1

- 前三季受通膨、美中競爭與俄烏戰爭影響，全球經濟景氣不振，記憶體廠調節產出，IC封測代工需求減少。
- 電競模組產品需求平穩，伺服器模組需求放緩，本公司因應客戶交期需求規劃產能並彈性調配人力，縮短交期以提高託工佔比。

2

第四季全球景氣仍低迷，記憶體市場在供應端減產效應下，庫存水位逐漸去化，市場需求緩慢回溫，供需狀況可望逐漸改善。

3

- 明年預計記憶體在車用、資料中心、AI、工控等領域的應用，將驅動記憶體產業保持成長動能。
- 本公司將持續發展覆晶技術、佈局新世代DDR5產品。
- 預期記憶體產業將持續發展與成長，本公司新廠擴建依原定時程。

市場展望

1

- 俄烏戰爭未歇，以巴衝突擴大，美中競爭持續，地緣政治風險仍高，大環境不確定因素仍為影響全球經濟景氣復甦關鍵。
- 記憶體廠持續調控產出，第四季短期急單增加，封測代工需求有升高趨勢。

2

- 庫存水位逐漸下降，客戶對PC、NB、行動裝置、消費性電子產品的封測代工需求可望漸次恢復正常。網路通訊、工控與車用記憶體需求相對較穩定。
- 模組方面，在雲端資料中心與AI運算需求帶動下，伺服器模組代工需求可望逐步改善。

3

預估2024年供給持續保守，需求則可望回升，庫存逐步去化下有助於供需恢復平衡，封測代工需求可望逐漸獲得改善。

4

問與答

